



**职位名称：品质及制造工程师**

**工作地点：南京**

**职位描述：**

- 负责 IC 封装（如 QFN、QFP、BGA、WLCSP）方案审查、工艺评估、质量控制，以及封装/产品认证;
- 负责工厂质量审核和能力管理;
- 负责装配工艺技术的评估和批准;
- 与工厂沟通合同及条款;
- 降低装配成本，提高产量、质量、周期，跟进项目进度。

**职位要求：**

- 本科及以上学历，理工科相关专业;
- 3 年以上集成电路装配工程经验，有封装开发经验者优先;
- 具有英文听说读写能力;
- 良好的跨部门和客户沟通经验;
- 工作积极主动，有良好的持续学习、团队合作和沟通能力，对工作有兴趣和热情。

We offer competitive remuneration package and excellent career prospects to the right candidate.

To apply, please send your full resume with current and expected salary by E-mail:

[recruit@solomon-systech.com](mailto:recruit@solomon-systech.com)